

国际智能材料研讨会暨 *Responsive Materials* 创刊会

会议通知

一、会议背景

智能响应材料是现代高技术新材料发展的重要方向之一，将支撑未来高新技术的发展。由东南大学和 Wiley 出版集团共同创办的 *Responsive Materials* 期刊以各种刺激响应的功能材料作为主要研究对象，聚焦化学、材料科学与工程、能源、环境、医药、智能生活及其他新兴领域的全球挑战性科学议题。

“国际智能材料研讨会暨 *Responsive Materials* 创刊会”拟于 2023 年 7 月 21 日至 7 月 25 日在江苏南京举行。会议旨在加强全球智能响应材料领域的交流合作，推动智能响应材料领域的学术和技术发展。

二、会议主题

智能材料的发展与现状。

三、会议主要信息

会议时间：2023 年 7 月 21 日至 7 月 25 日（21 日全天-22 日上午报到）

会议地点：南京市上秦淮假日酒店（江苏省南京市江宁区秣周东路 21 号）

四、会议重要时间节点

6 月 15 日，第一轮通知，注册、论文投稿、缴费开始日期

6 月 30 日，第二轮通知，优惠缴费截止日期

7 月 10 日，论文投稿截止日期，注册截止日期

7 月 12 日，第三轮通知

五、会议组织

主办：东南大学

承办：东南大学智能材料研究院，东南大学化学化工学院，*Responsive Materials* 编辑部，东南大学国际合作处

支持单位：Wiley 出版集团，新型显示与视觉感知石城实验室，*Light: Science & Applications* 编辑部

学术委员会

主席：Quan Li (Southeast University, China)

委员（按姓氏字母排序）：

Bo Albinsson	Chalmers University of Technology, Sweden
Ivan Aprahamian	Dartmouth College, USA
Liming Dai	University of New South Wales, Australia
Michael Dickey	NC State University, USA
Oleg Gang	Columbia University, USA
Zijian Guo	Nanjing University, China
Stefan Hecht	Humboldt-Universität zu Berlin, Germany
Rebecca Kramer-Bottiglio	Yale University, USA
Mark MacLachlan	University of British Columbia, Canada
Carmel Majidi	Carnegie Mellon University, USA
Rodrigo Martins	NOVA University Lisbon, Portugal
Paula M. Mendes	University of Birmingham, UK
Takashi Miyata	Kansai University, Japan
Kasper Moth-Poulsen	Chalmers University of Technology, Sweden
Takashi Nakanishi	National Institute for Materials Science, Japan
John A. Rogers	Northwestern University, USA
Paolo Samorì	University of Strasbourg, France
Jean-Pierre Sauvage	University of Strasbourg, France
Albert P. H. J. Schenning	Eindhoven University of Technology, Netherlands
Ben Zhong Tang	The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen), China
He Tian	East China University of Science & Technology, China
Alain Tressaud	CNRS and University of Bordeaux, France
Vladimir V. Tsukruk	Georgia Institute of Technology, USA
Diederik Wiersma	University of Florence, Italy
Shiki Yagai	Chiba University, Japan
Yadong Yin	University of California Riverside, USA
Xi Zhang	Tsinghua University, China
Lei Zhu	Case Western Reserve University, USA

组织委员会

主席：孙岳明，王保平

秘书长：周建成，王晨，杜峰

六、与会嘉宾



Jean-Marie Lehn
University of
Strasbourg
France



Jean-Pierre Sauvage
University of
Strasbourg
France



Ivan Aprahamian
Dartmouth College
USA



Mark MacLachlan
University of British
Columbia
Canada



Rodrigo Martins
NOVA University
Lisbon
Portugal



Paula M. Mendes
University of
Birmingham
UK



Takashi Nakanishi
National Institute for
Materials Science
Japan



John A. Rogers
Northwestern
University
USA



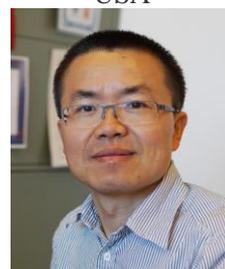
Xin Su
Executive Editor
Angewandte Chemie



Ben Zhong Tang
The Chinese
University of Hong
Kong (Shenzhen)
China



Guangchen Xu
Editorial Director,
Wiley China
Physical Sciences



Yadong Yin
University of
California Riverside
USA



Ying Zhang
Editor,
*Light: Science &
Application*



Lei Zhu
Case Western
Reserve University
USA

持续更新中

七、会议注册及相关费用

1. 请访问官方网站 <http://www.iams.org.cn/>，进行在线注册，创建参会账号，并完善发票及其他相关信息。如有意投海报或口头报告，请从官方网站下载模板并发送摘要至：RM2023SEU@126.com，邮件主题为“智能材料研讨会口头/海报+注册人姓名+单位名”。

2. 注册费用

缴费时间	非学生	学生
2023年6月30日前	2500	1200
2023年7月1日后	3000	1500

* 为使您享受优惠的注册费和更好的服务，请您在优惠缴费截止日期前缴费；

* 有论文参会的代表请务必于2023年7月10日前缴费；

* 注册费标准以缴费日期为准，不以注册日期为准。

3. 注册费缴纳可采用以下两种方式之一

(1) 银行汇款

开户银行：建设银行南京四牌楼支行

账户名称：东南大学

开户账号：32001594138059123456

汇款单必须标注：智能材料研讨会+注册人姓名+单位名称。汇款后请将汇款凭证扫描件、单位及纳税人识别号发送到邮箱 RM2023SEU@126.com，团队缴费需备注所有人员名单。如有特殊需求请一并在邮件中说明。

(2) 现场缴费

未能提前缴纳注册费的参会代表，请在会议报到时现场缴纳并提供发票信息和邮寄地址，现场仅接受刷卡缴费。

会务组将在会将电子发票发送到参会代表邮箱。

八、住宿与交通

1. 住宿：本次会议推荐酒店将在会议网站（<http://www.iams.org.cn/>）陆续推出，参会代表可通过会议网站预定优惠酒店，或自行通过其他网络平台预定，住宿费用由参会代表自行结算。

序号	酒店名称	星级	酒店地址	与会议地址距离
----	------	----	------	---------

1	上秦淮假日 酒店	五星 级	南京市江宁区秣周东路 21 号 025-84908888	会议举办地
2	九龙湖宾馆		南京市江宁区苏源大道 77 号 025 8106 9555	距离会场 6.6 公 里

2. 交通指南:

地铁: 地铁 3 号线 (秣周东路方向) 于秣周东路站 2 号口出站, 步行 100 米至南京上秦淮假日酒店。

出租车: 距禄口机场约 20 公里, 约 30 分钟; 距南京南站约 15 公里, 约 25 分钟; 距南京站约 30 公里, 约 45 分钟。

九、会议联系方式

会议主页: <http://www.iams.org.cn/>

会议邮箱: RM2023SEU@126.com

总联系人:

杜 峰 13372015601 邮箱: feng_du@seu.edu.cn

在线注册:

刘志洋 15058280163 邮箱: liuzhiyang@seu.edu.cn

杨 涛 18114706120 邮箱: yt1990.9@gmail.com

赞助厂商:

陈旭漫 13813390695 邮箱: chenxm@seu.edu.cn

张 曙 15151825721 邮箱: shu_zhang@seu.edu.cn

墙报摘要:

贺美霞 15289459287 邮箱: meixiahe@seu.edu.cn

黄帅 18810998698 邮箱: huangshuai1991@seu.edu.cn

酒店交通:

袁玉生 17314430276 邮箱: yushengyuan@seu.edu.cn

邢俊飞 15351948180 邮箱: junfeixing@seu.edu.cn

微信公众号: Responsive Materials 响应材料



东南大学智能材料研究院

东南大学化学化工学院

2023 年 6 月 15 日